

概要

半導体パッケージの小型化、高速化、多機能化の要求は依然として根強く、最近ではシリコン貫通電極の技術を適用しようという動きが活発化している。

シリコン貫通電極は半導体チップ自体を貫通する導電経路を形成し、末端電極同士を接合することで、パッケージサイズの小型化が実現でき、さらには異種のチップを三次元に実装することにより多機能化するというものである。

我々は、シリコンを基材としたインターポージャー基板に着目し、貫通電極形成の開発を開始した。

今回は、シリコンインターポージャーに関する技術的な課題を中心に発表するものである。

経歴

秋山直之(あきやま なおゆき)

1986年 凸版印刷株式会社入社

1998年よりエレクトロニクス事業部門、本社・研究開発部門にてプリント配線版、半導体関連部材の開発に従事、現在に至る。

エレクトロニクス事業本部 事業戦略本部 新商品開発部 主任